公司代码:601231 公司简称:环旭电子
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	黄江东	重要工作时间冲突	仓勇涛

4、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,每10股派发现金红利2.30元（含税）,不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的,保持拟分配的每股现金红利不变,相应调整分配总额。

公司2024年年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,尚需公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	环旭电子	601231	无
可转换为公司A股股票的可转换公司债券	上海证券交易所	环旭转债	113045	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史金鹏	冯超
联系地址	上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼	上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼
电话	021-58968418	021-58968418
传真	021-58968415	021-58968415
电子信箱	Public@usiglobal.com	Public@usiglobal.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司所处行业为电子制造服务行业,公司产品主要服务于消费电子、云端存储、工业、汽车电子和医疗等行业领域。公司所服务产品、业务布局和经营呈现模组化、多元化和全球化的特点。

（一）行业基本情况

电子制造服务行业主要为各类电子产品和设备提供设计、工程开发、原材料采购、生产制造、测试、物流及售后服务等综合解决方案。

电子制造服务涉及的主要产品领域包括3C（即:Computer、Communication、Consumer Electronics）、云端、人工智能、汽车、工业、医疗、交通、能源、航空航天等,其中消费电子在电子制造服务业中占有最重要的份额。智能手机、智能穿戴设备、AR/VR设备、电脑、算力及云端产品、智能家居、智能座舱等产品需求增长,带动了芯片、存储、电子元件、模组及智能制造的快速发展和持续升级。

中国在全球电子制造服务业占有最大的市场份额和最具竞争优势的供应链。全球供应链近岸外包、友岸外包的需求快速增加,明显拉动在墨西哥、东南亚、印度、东欧等区域的投资和产能扩建,对上游供应链的产能转移也有影响,进而在未来形成新的产能规模和产业链的群聚。此外,受到美国对中国及墨西哥加征关税的影响,会推动供应链在具有地缘优势、政策优势和成本优势的地区投资布局新产能,降低因特定区域加征关税所带来的经营风险;同时也会促使企业加大研发投入,推动技术创新,以提高产品附加值,减少对低附加值制造环节的依赖,增强在高关税环境下的竞争力。

（二）行业特点及发展趋势

1、行业整体规模大,产业集中度高

根据行业统计的数据,2024年全球电子制造服务行业的产业规模约6,332亿美元,行业集中度高,全球排名前十的厂商营收占比超过七成。行业内龙头企业积累了丰富的客户资源和行业经验,拥有强大的供应链管理及竞价能力,资产和营收规模较大,其领先地位稳固。

2024年电子产品依然处于供应链去库存阶段,库存水平逐渐向合理区间回归,全球主要经济体的通货膨胀水平在2024年整体呈现温和态势,货币政策有所转向,全球进入降息周期,美元加息步伐停止并开启降息通道,这对行业需求产生了一定积极影响,有望在2025年带动电子产品需求的回升。

2、经营及竞争环境日益复杂,电子制造服务商面临转型

地缘政治和全球经贸区域化趋势影响全球供应链的重构,客户为实现供应链多元化的风险管理需要,部分离岸外包转向近岸或友岸外包,需求和订单调整变化较快。当下,在美国对中国、墨西哥、加拿大以及其他潜在区域加征关税的举措将导致电子制造服务产业的成本增加,所处的经营环境及竞争环境也将更加复杂,电子制造服务商也在积极转型升级,争取在供应链上扮演更重要的角色。

（1）下游客户与上游电子制造服务商的合作融合加深

终端消费电子品牌商、云服务商及其他品牌厂商不再仅仅是订单的下达者,而是更深入地参与到电子制造服务商的生产过程中,包括技术研发、生产计划制定、质量控制等环节。同样的,电子制造服务商也不再只是被动地按照订单生产,而是积极参与到品牌商的产品规划和设计中,提供专业的技术和工艺建议,从而双方形成更紧密的合作伙伴关系。

（2）综合化服务转型

技术进步持续推动电子产品和设备升级迭代,AI的大规模应用将促进电子产品不断向智能化、小型化、高性能化方向发展。这使得行业内的企业长期处于较大的经营压力下,需要在产品创新方面不断投入研发资源,推出符合市场需求的新产品;在品质提升方面,提高产品良率和质量;在降本增效方面,通过引入智能化、自动化的生产能力以降低生产成本,提高生产效率。企业还需要努力开拓新产品和客户增量需求,增强设计开发能力,精进工艺制程,提升智能制造及新产品研发能力,强化与客户的合作粘性,增加产品附加值。

上游电子制造服务商将从单纯的产品制造向提供综合服务转变,除了生产硬件产品外,还将提供产品设计、测试、维修售后等全生命周期服务,以在激烈的市场竞争中脱颖而出。

（3）数据驱动的协同决策

随着大数据、AI等技术的应用,品牌厂商和电子制造服务商将更加依赖数据来进行决策。通过共享生产、销售、市场等多方面的数据,双方能够更准确地预测市场需求、优化库存管理、制定生产计划,实现供应链管理的精耕细作。

（4）全球在地化合作

品牌厂商为了降低风险、提高供应链的弹性,将倾向于与具有全球布局能力的电子制造服务企业合作,形成多元化的供应商体系。电子制造服务商也将积极拓展全球市场,与不同国家和地区的客户建立合作关系,实现资源的优化配置和全球供应链的整合。

（5）可持续发展和绿色转型

在全球对环境保护和可持续发展日益重视的背景下,电子制造服务商也将承担起可持续发展的责任。从产品设计、原材料采购、生产过程中的能源消耗和废弃物处理,到产品的回收和再利用,推动产品的绿色转型,以降低产品生命周期对环境的负面冲击。

3、AI落地端侧推动消费电子智能化升级

当前AI已被广泛认为将成为继蒸汽机、内燃机、电力、半导体和信息技术之后,人类又一座具有奠基意义的科技进步里程碑,AI能够赋能各行各业已成共识。通过AI赋能或"AI+",消费性电子产品有望在交互方式、操作便捷、强化原有功能、智能服务、生态创新等方面实现新突破。此外,在数据安全与降本需求的推动下,AI模型的部署也开始从云端走向移动终端和边缘终端。

消费电子知名品牌商及部分新创品牌商,纷纷推出"AI+"的消费电子产品,如Apple Intelligence技术在手机端展现出了丰富且强大的智能应用,利用本地运行的生成式人工智能模型,为用户提供智能影像及创作、健康监控、通话翻译、会议纪要整理、行程安排等功能,以更流畅的交互对话完成以往需要复杂工具和操作才能完成的事项。同时,Apple Intelligence在设备端处理敏感数据,如语音指令、照片分析等,避免数据上传至云端带来的隐私风险,确保用户数据安全。市场上推出的AI Glass、AI PC、AI智能家居等产品,也吸引了消费者的广泛关注。

未来,人们在居家、工作、出行等生活场景中,使用AI赋能的核心终端设备,如手机、电脑、边缘服务器等,借助高带宽、低延时、易接入的新一代通讯技术,如WiFi 7、UWB、mmWave等,实现与智能穿戴设备（如Smart Watch、TWS耳机、XR设备等）和家庭、办公场景下的智能物联网设备（如家电、家居、办公设备等）之间的无缝连接和数据互通,基于万物互联（AIoT）和AI大模型技术,AI通过主动感知、智能分析、实时互动等方式,协同各类电子设备,为用户提供智能、高效、便捷的服务。

4、AI算力、数据交换需求激增

自ChatGPT引爆AI热潮,2024年生成式人工智能大模型加快迭代,AI大模型训练及推理的需求越来越高,GPU和AI服务器供不应求,同时也大幅带动数据传输和交换相关硬件产品的需求。DeepSeek通过提供低成本、高性能的AI大模型,大幅降低了AI技术的应用门槛,未来将使得更多企业和开发者能够涉足AI领域,推动AI技术赋能各行各业。

AI算力投资不仅增加对GPU、ASIC、交换机、存储等硬件的需求,也带动边缘服务器和AI加速卡等需求增长。AI大模型需要更高效率、更低延迟的数据传输和交换,推动网络基础设施的升级,高速光纤网络、高速光模块、HBM、高速网卡及交换机、散热及服务器冷却系统等硬件产品需求快速成长。

AI的快速发展也使得用电需求大幅增加,基于不同芯片搭建的服务器电源功率亦在升级,电源作为高性能计算和数据中心的基础设施,其需求也得到快速成长。同时,用电量大幅上升的背景下,高效服务器电源重要性提升,一方面减少转换过程中的损耗,另一方面GPU的升级亦需更高功率密度的电源支持。

5、全球经济软着陆,为工业类产品需求提供支撑

2024年全球经济仍面临经济增长动能偏弱、通胀回落放缓以及地缘政治冲突、国际贸易摩擦频发等挑战。根据国际货币基金组织（IMF）、世界银行和经济合作与发展组织（OECD）等机构的预测,2025年全球经济预计将保持温和增长,但增速可能低于疫情前的平均水平。

全球经济的温和增长将为工业类产品需求提供一定的支撑,但需求增长可能较为缓慢且存在区域分化。制造业、基础设施和新能源领域的工业产品需求有望保持增长,而传统制造业和消费品领域的需求可能受到经济结构调整和政策环境的影响。

6、欧美车企积极应对竞争,电动车普及率继续扩大

全球汽车市场增速明显放缓,新能源汽车仍保持较高增速。在新能源汽车领域,中国车企凭借高性价比、先进的电池技术和快速发展的智能网联功能,逐渐在全球市场占据重要份额,但欧美车企凭借其在品牌、技术、市场和政策等方面的优势,依然在全球汽车市场占据重要地位,未来将通过加速技术创新、优化市场布局、加强供应链管理、强化品牌建设,以及利用环保法规、补贴政策、贸易保护措施等,与中国车企展开全方位的竞争。

在欧美汽车市场,碳排放法规和补贴政策将继续推动电动汽车的普及。电动汽车(BEV)和混合动力汽车(HEV)的市场份额将进一步扩大,自动驾驶功能和智能网联服务将成为主流,传统车企与中国车企、新势力车企之间的竞争将更加激烈。欧洲车企将继续推动供应链的多元化,减少对单一供应商的依赖,特别是在电池和芯片供应方面,美国政府将继续推动汽车零部件生产回流北美,减少对中国供应链的依赖。

7、机器人和具身智能发展的潜在业务机遇

工业机器人和工业4.0技术在电子制造行业的应用已非常普遍,帮助实现生产效率提升、质量控制优化、智能物流管理、人机协作、设备维护、安全风险管理等。家用清洁机器人、物流配送机器人等服务机器人的发展也方兴未艾。Optimus的发布及持续更新迭代,引领整个机器人行业的快速发展,人型机器人（Humanoid Robots）和具身智能（Embodied Intelligence）成为人工智能和机器人技术的前沿领域,具备非常广阔的发展潜力和深远影响。

机器人需要集成和使用的电子器件种类繁多,涵盖了从微控制器、传感器、电机驱动器、电源管理模块、通讯模块到机器视觉、人工智能和机器学习加速器等众多领域。这些器件共同构成了机器人的核心系统,使其能够实现复杂的运动控制、环境感知、数据处理和人机交互功能。机器人技术的发展,离不开高性能、低功耗、智能化的电子器件的基础支撑,未来也将创造巨大的需求增量。

（三）行业周期性、区域性和季节性特征

1、行业发展的周期性

电子制造服务行业的发展受下游行业的需求周期性的影响较为直接。电子产品的需求受宏观经济环境、经济周期、消费者偏好和技术创新等因素影响。经济景气时,电子产品的市场需求增长,带动电子制造服务行业产销量增加;经济低迷时,消费者及企业购买力下降,产品需求减少,行业产销量减少。

2、行业的区域性

全球电子制造服务行业兴起于欧美,然后逐渐向东南亚、中国台湾和中国大陆转移。目前,中国、东南亚、印度、墨西哥、东欧等地是低成本制造的区域中心。当前"经贸区域化"和"在地化"制造的趋势有利于区域内低成本制造中心的发展,但以中国大陆为代表的亚太供应链仍具备"产业集群"和"低成本"优势。

3、行业的季节性

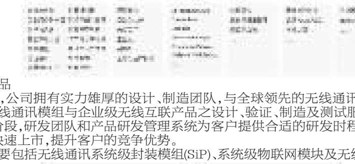
受传统消费习惯的影响,消费电子品牌厂商下半年订单占比较高,造成电子制造服务行业的出货及收入具有一定的季节性特征。每年的第一、二季度为传统淡季,下半年开始进入销售旺季,逐月攀升到出货高点后正常回落。

（四）公司在行业中的竞争地位

公司是电子制造服务行业的全球知名厂商,根据全球电子制造服务商最新排名（2023年度）,环旭电子排名为第十二位,营收年增长率和营业净利润率居行业前列。公司是SiP微小化技术的行业领导者,在多个业务细分领域居行业领先地位。

（一）主要产品与解决方案

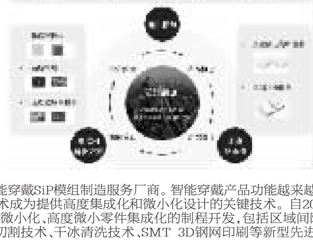
公司是全球电子制造设计领导厂商,通过为品牌客户提供更有附加值的设计制造及相关服务,参与产品的应用型解决方案,提升产品制造及整体服务的附加值。公司未来将更加注重在解决方案(Solution)、设计(Design)及服务(Service)环节的能力,为客户创造核心价值,与各行业领域的优质客户建立长期稳定的合作关系,从制造服务商逐步发展成为系统方案解决商及综合服务商。



1、无线通讯类产品

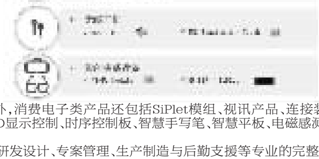
在无线通讯领域,公司拥有实力雄厚的设计、制造团队,与全球领先的无线通讯芯片厂商紧密合作,为客户提供行业领先的无线通讯模组与企业级无线互联产品之设计、验证、制造及测试服务。从产品概念、原型设计、测试验证到量产阶段,研发团队和产品研发管理系统为客户提供合适的研发时程和可靠的品质保障,满足客户需求,实现产品快速上市,提升客户的竞争优势。

无线通讯产品主要包括无线通讯系统级封装模组(SiP)、系统级物联网模块及无线路由器等。



2、消费电子产品

公司是业界领先的智能穿戴SiP模组制造服务厂商。智能穿戴产品功能越来越丰富,不断趋向"轻、薄、短、小",系统级封装（SiP）技术成为提供高度集成化和微小化设计的关键技术。自2013年起,公司开始致力于可穿戴式产品相关SiP模组的微小化、高度微小零件集成化的制程开发,包括区域间隔屏蔽、选择性塑封、薄膜塑封技术、选择性溅镀、异形切割技术、干冰清洗技术、SMT 3D钢网印刷等新型先进封装技术。目前,智能穿戴SiP模组产品涵盖智能手表SiP模组、真无线蓝牙耳机(TWS)模组、光学心率模组等。在XR(VR/AR/MR)以及智能眼镜等智能头戴式设备上,公司产品包括WiFi模组、多功能集成或特定功能的SiP模组。



除智能穿戴SiP模组外,消费电子类产品还包括SiPlet模组、视讯产品、连接装置等产品领域,主要包括X-Y条形控制板、miniLED显示控制、时序控制板、智慧手写笔、智慧平板、电磁感测板等。

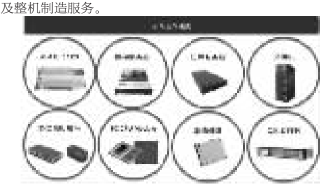
3、工业类产品

结合丰富经验的产品研发设计、专案管理、生产制造与后勤支援等专业的完整服务团队,公司致力于工业产品市场,如销售点管理系统(POS)、智能手持终端机(SHD)、智能车队记录仪、工厂自动化控制模块等,为客户提供最具成本效益的优化设计,满足客户从大量生产到少量多样的客制化需求,透过严格管控的品管流程,提供客户完整的套装解决方案。伴随全球碳中和的发展需要,公司增加了服务储能、光伏的绿色能源产品。

4、云端及存储类产品

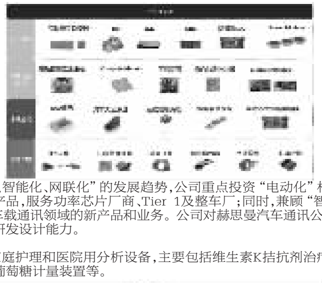
公司主板产品主要包括服务器主板、AI Card、工作站主板、笔记本电脑的CPU Module等;电脑周边产品主要包括笔记本电脑的扩展坞(Docking Station)、外接适配器(Dongle)产品,拓展笔记本电脑外接其他设备的功能的产品。公司制造的服务器相关产品主要应用于云计算、数据中心、边缘计算等领域,在标准机架式服务器、边缘服务器方面,公司提供JDM（Join Design Manufacture,联合设计制造）服务模式,已应用DDR5、PCIe-G5等新一代技术。

存储和互联产品主要包括固态硬盘(SSD)和高速交换机、网络适配卡。公司拥有领先的新技术开发能力,如:光纤信道、SAS、SATA、10G以太网络、Rapid IO及无限宽带等。公司是领先的固态硬盘设计与制造合作伙伴,为客户提供的制造服务涵盖硬件设计、产品验证以及定制开发的生产测试平台等。公司也为客户提供高速交换机(Switch)产品的主板及整机制造服务。



5、汽车电子类产品

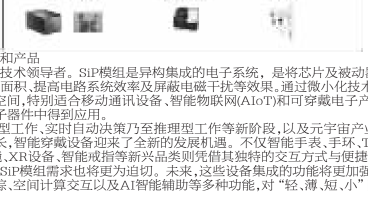
公司在汽车行业拥有超过40年的经验,是汽车电子产品的领先制造服务商。汽车电子产品主要包括功率模组（Power Module）、驱动牵引逆变器、BMS(Battery Management System)、OBC(On-Board Charger)、电子泵、智能座舱产品、ADAS相关控制器、域控制器、车载NAD模块、车载天线、LED车灯、其他车身控制器产品等。



围绕汽车电子"电动化、智能化、网联化"的发展趋势,公司重点投资"电动化"相关的功率模组及牵引驱动逆变器、BMS、OBC等产品,服务功率芯片厂商、Tier 1及整车厂;同时,兼顾"智能化"和"网联化"领域,拓展智能座舱、ADAS、车载通讯领域的新产品和业务。公司对赫思曼汽车通讯公司的收购,加强公司在汽车天线、汽车通讯领域的研发设计能力。

6、医疗电子产品

医疗电子产品主要是家庭护理和医院用分析设备,主要包括维生素K拮抗剂治疗仪、医用无线血糖仪、睡眠呼吸机、血液分析机和葡萄糖计量装置等。



（二）微小化设计和产品

公司是SiP微小化技术领导者。SiP模组是异构集成的电子系统,是将芯片及被动器件整合在一个模块中,达到缩小功能模块面积、提高电路系统效率及屏蔽电磁干扰等效果。通过微小化技术,可以减小大多数电子系统占用的尺寸和空间,特别适合移动通讯设备、智能物联网(AIoT)和可穿戴电子产品的发展需求,也有机会在机器人所需电子器件中得到应用。

随着AI迈向增强型工作、实时自动决策乃至推理型工作等新阶段,以及元宇宙产业创新相关的空间计算市场规模的大幅增长,智能穿戴设备迎来了全新的发展机遇。不仅智能手表、手环、TWS耳机等传统品类持续迭代升级,AI眼镜、XR设备、智能戒指等新兴品类则凭借其独特的交互方式与便捷性,成为市场新宠,对轻薄短小、高集成度的SiP模组需求也将更为迫切。未来,这些设备集成的功能将更加强大,深度融合健康监测、语音交互、运动追踪、空间计算交互以及AI智能辅助等多种功能,对"轻、薄、短、小"的追求也将达到新的高度。

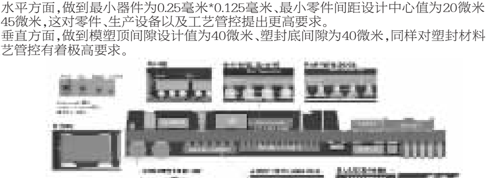
在机器人的复杂系统中,电控模组(Electronic control unit)和通讯模组是实现精准控制与高效数据传输的关键,而其微小化进程面临诸多挑战,如散热和轻量化等问题。环旭电子的微小化技术能够有效应对这些挑战,通过高集成度的设计,不仅能减小模组尺寸,还能提升其可靠性与稳定性,满足机器人在不同应用场景下的严苛功能要求。

公司坚持深耕SiP模组的研发领域,保持业界领先。2020年底,公司设立微小化研发创新中心（MCC）,围绕微小化技术和SiP模组的应用推广,服务国内外客户对微小化、模组化的产品需要,提供从设计到制造的"一站式服务"。

公司在SiP制程各方面不断突破技术挑战,满足高稳定性、高集成度的产品要求:

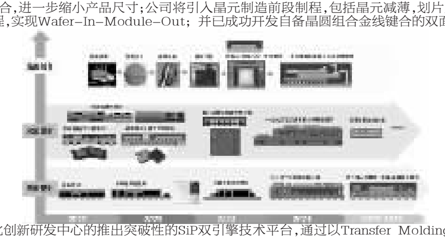
（1）水平方面,做到最小器件为0.25毫米*0.125毫米、最小零件间距设计中心值为20微米、离板边间距设计值为45微米,这对零件、生产设备以及工艺管控提出更高要求。

（2）垂直方面,做到模塑顶间隙设计值为40微米、塑封底间隙为40微米,同样对塑封材料选择、工艺参数以及工艺管控有着极高要求。



（3）选择性塑封、插入式互联、薄膜辅助模塑直接漏出锡球以及利用铜柱取代BGA植球达成高密度连接接口等技术为SiP互联、后续工艺提供多样化支持。

"微小化"产品的设计制造能力是公司的竞争优势,公司在SiP模组设计与制程工艺方面不断精进。单面塑封方面,当前可以全面塑封也可以选择性塑封,还可以做选择性台阶塑封,后续会开发夹心饼干式多板堆叠封装,及芯片埋入式基板组合金线/晶元键合封装;在双面塑封方面,已引入插入式互联,后续会开发3D结构以及软硬板结合,进一步缩小产品尺寸;公司将引入晶元制造前段制程,包括晶元减薄,划片及卷带包装;结合当前SiP制程,实现Wafer-In-Module-Out;并已成功开发自备晶圆组合金线键合的双面塑封模组。



MCC微小化创新研发中心的推出突破性的SiP双引擎技术平台,通过以Transfer Molding为主的高密度集成技术满足大规模、高度整合且追求极致微小化模块需求;同时以Vacuum Printing Encapsulation为中心的高度弹性技术为模块封装提供了创新的方法,透过在真空腔体中以液态封胶印刷方式实现塑封而不需要定制模具,开发周期能够大幅缩短,故而此创新解决方案可针对不同的市场应用进行快速模块化设计。

SiP双引擎技术平台可提供少样多量或者是多样少量等高灵活的系统封装解决方案。平台可依据客户的需求提供最适合的解决方案,提高产品质量。

MCC微小化创新研发中心的能力不限于SiP双引擎技术平台,还涵盖将各种异质组件整合到复杂模块中。公司开发团队拥有全方位的设计服务和专用的生产设备,能为客户从产品概念到量产提供无缝衔接的服务,确保在复杂的系统集成项目中的可量产性,也为产品的最终性能和可靠性提供坚实保障。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年
		调整后	调整前		
总资产	39,998,030,835.37	39,404,295,828.93	39,306,382,898.66	1.51	38,574,464,731.16
归属于上市公司股东的净资产	17,934,523,876.88	16,993,068,434.84	16,990,407,623.67	5.54	15,749,394,179.86
营业收入	60,690,651,098.10	60,791,909,537.87	60,791,909,537.87	-0.17	68,516,075,963.26
归属于上市公司股东的净利润	1,652,482,815.41	1,947,846,866.12	1,947,846,866.12	-15.16	3,059,967,081.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,450,740,530.12	1,779,078,630.35	1,779,078,630.35	-18.46	3,010,200,488.88
经营活动产生的现金流量净额	4,210,266,611.54	6,823,435,492.62	6,823,435,492.62	-38.30	3,435,196,255.50
加权平均净资产收益率（%）	9.52	12.02	12.02	减少2.50个百分点	21.43
基本每股收益（元/股）	0.76	0.89	0.89	-14.61	1.40
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.87	0.87	-13.79	1.35

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	13,491,928,720.52	13,893,681,673.09	16,621,097,158.49	16,683,943,546.00
归属于上市公司股东的净利润	334,683,660.30	449,720,127.00	512,525,041.64	355,553,986.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	286,600,179.96	315,218,801.67	452,580,701.73	396,340,846.76
经营活动产生的现金流量净额	1,146,121,777.94	351,742,514.06	500,647,286.74	2,211,755,032.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

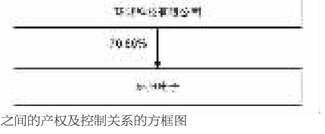
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）							39,310
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							39,244
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
环诚科技有限公司	0	1,683,749,126	76.86	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	18,525,171	83,230,028	3.80	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	-23,700	22,893,936	1.05	0	未知		国有法人
日月光半导体（上海）有限公司	0	18,098,476	0.83	0	无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,567,602	9,135,802	0.42	0	未知		其他
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	-16,605,145	6,740,400	0.31	0	无		其他
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	3,025,057	5,452,900	0.25	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金		5,204,700	0.24	0	未知		其他
黄志龙	3,100,000	3,850,000	0.18	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金		3,408,700	0.16	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人,其为兄弟关系,张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体(上海)有限公司,从而最终实际控制本公司,公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

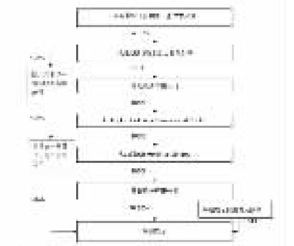
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2024年实现营业收入606.91亿元,较2023年的607.92亿元同比降幅0.17%。其中,云端及存储类产品营收同比增长13.35%;汽车电子类产品营收同比增长16.24%;医疗电子类产品营收同比减少11.21%;通讯类产品营收同比减少3.36%;消费电子类产品营收同比减少0.27%;工业类产品营收同比减少12.82%。营业收入变动的主要原因为:（1）云端及存储类产品营业收入同比增长主要受益于行业需求恢复及新技术应用的发展;（2）汽车电子类产品营业收入同比增长主要受益于合并赫思曼汽车通讯公司的报表;（3）工业类产品受下游需求影响,同比出现下滑。

公司2024年销售费用、管理费用、研发费用及财务费用总额为40.00亿元,较2023年期间费用35.76亿元同比增长4.24亿元,同比增长11.86%。

公司2024年实现营业利润18.72亿元,较2023年的21.78亿元减少14.01%;实现利润总额18.54亿元,较2023年的21.90亿元减少15.34%;实现归属于上市公司股东的净利润16.52亿元,较2023年的19.48亿元减少15.16%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-017
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

●本次会计政策变更不会对环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、关于流动负债与非流动负债划分的相关会计政策变更

（一）本次会计政策变更概述

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号,以下简称"《解释第17号》"）,并规定自2024年1月1日起施行,企业在首次执行本解释的规定时,应当对可比期间信息进行调整。

《解释第17号》对《企业会计准则第30号一财务报表列报》中流动负债和非流动负债的划分原则进行了修订与完善,说明如下:

1、明确了若企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性,并不影响负债的流动性划分;

2、对于企业贷款安排产生的负债,若企业推迟清偿负债的权利取决于企业是否遵循贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件）时,应当区分在资产负债表日或者之前以及在资产负债表日之后两个情况进行判断,进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分;

3、明确了若企业负债的交易对手可选择以企业自身权益工具进行清偿且该选择权分类为权益工具并单独确认的,相关条款不影响该负债的流动性划分;

4、明确了附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排,且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的披露要求。

（二）本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

公司对于《解释第17号》中流动负债与非流动负债的划分原则进行了评估及确认,公司评估后认为:本次会计政策变更仅是根据财政部发布的企业会计准则解释进行的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

二、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的相关会计处理变更

（一）本次会计政策变更概述

2024年12月6日,财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号,以下简称"《解释第18号》"）,对关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理作了明确的说明和规定,并自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

根据《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定,对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应当根据《企业会计准则第13号一或有事项》（财会〔2006〕3号）有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。企业在首次执行时,如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"的,应当按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更并进行追溯调整。

（二）本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

在财政部发布《解释第18号》前,公司将保证类质量保证的金额计入"销售费用"列示。发布后,公司将2023年度保证类质量保证的金额进行追溯调整,从"销售费用"重分类至"营业成本"项目中。

本次会计政策变更对公司财务报表相关科目及金额之影响,具体情况如下:

合并利润表			
			单位: 人民币元
项目	按原列报的项目金额2023年度	会计政策变更的调整金额	按新列报的项目金额2023年度
营业成本	54,939,136,481.69	26,710,213.12	54,965,846,694.81
销售费用	367,994,662.03	(26,710,213.12)	341,284,448.91

母公司利润表			
			单位: 人民币元
项目	按原列报的项目金额2023年度	会计政策变更的调整金额	按新列报的项目金额2023年度
营业成本	17,928,507,549.98	12,556.36	17,928,520,106.34
销售费用	77,474,832.09	(12,556.36)	77,462,275.73

公司评估后认为:本次会计政策变更除对利润表的列报项目及其对应金额有所影响外,亦对毛利率等财务指标产生小幅影响,但对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-023
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司
关于签署日常关联交易框架协议的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●本次日常关联交易主要基于公司日常经营业务需要而发生,按市场定价原则,定价客观、合理、公允,不会损害公司利益,不会对公司独立性造成影响,也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

●风险提示:本次《日常性关联交易框架协议》的签署为双方合作意向和原则的框架性陈述。双方将根据本协议,就包括但不限于上述协议事项的具体内容展开进一步商谈,双方就以上各事项的最终合作将以双方后续商谈结果及由此形成的进一步协议为准。

为满足公司日常生产运营的需要,环旭电子股份有限公司（包括环旭电子附属公司,下同,以下简称"公司"或"环旭电子"）与日月光投资控股股份有限公司（包括除环旭电子之外的日月光投控附属公司,下同,以下简称"日月光投控"）需就厂房租赁、日常销售及采购、接受及提供劳务等进行日常性关联交易。双方经诚信、友好协商,同意签署《日常性关联交易框架协议》（以下简称"《框架协议》"）并按其约定进行日常关联交易,双方同意并保证本公司及各自附属公司按照协议的条款和精神,履行各自的义务。

一、《框架协议》履行的审议程序

1、独立董事专门会议审查情况

公司于2025年3月26日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议。经过认真审阅相关资料,听取公司管理层汇报,独立董事认为公司与关联方日月光投资控股股份有限公司签署的日常关联交易框架协议,主要为满足公司日常生产运营的需要,以公司正常经营业务为基础,交易遵循公平原则,交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准,不会对公司独立性及规范运作产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

2、审计委员会审议

公司于2025年3月28日召开第六届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于公司签署日常关联交易框架协议的议案》,关联委员陈昌益先生回避表决,非关联委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3、董事会表决情况及关联董事的回避表决情况

公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司签署日常关联交易框架协议的议案》,同意公司与关联方日月光投控签署《框架协议》。关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生对该议案回避表决。

二、关联方介绍和关联关系说明

1、关联方介绍

公司名称:日月光投资控股股份有限公司
公司类型:股份有限公司
注册资本:新台币5,500,000万
成立日期:2018年4月30日
注册地址:高雄市楠梓区经三路26号
法定代表人:张虔生
实际控制人:张虔生
经营范围:一般投资业

2、关联关系说明

公司与日月光投控为同一控制人控制的企业。

3、关联方履约能力分析

日月光投控为台湾上市公司（股票代码:TW3711）,财务状况和资信状况良好,生产经营情况正常,具备良好的信誉和履约能力,在与公司合作过程中可严格遵守合同约定,具有较强的履约能力。

三、《框架协议》基本内容

1、交易双方

甲方:环旭电子股份有限公司
乙方:日月光投资控股股份有限公司

2、交易标的

环旭电子与日月光投控关于相关宿舍、厂房、办公房屋的租赁,以具体协议所列的地址、面积、租赁期限、交易金额等为准。

环旭电子与日月光投控（包含其附属子公司）关于日常关联销售、关联采购及接受及提供劳务等交易。

3、交易定价原则

甲乙双方（包括并代表其各自附属公司）承诺,本协议项下之交易应遵循公平原则,交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准,本协议项下之交易的交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。

甲乙双方（包括并代表其各自附属公司）承诺和保证,其交易的价格公平及合理,并且该价格按照市场价;如无该等市场价,执行协议价。

（1）"市场价":是指按照下列顺序依次确定的价格:（a）在该类产品或服务的提供地或其附近地区在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格;或（b）若以上第（a）款不适用时在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。

（2）"协议价":即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润。

环旭电子及日月光投控（包括并代表其各自附属公司）就本协议项下的交易事项依法订立书面的具体协议（下称"具体协议",无论采取何种形式）。每份具体协议会载列有关订约方所要求的特定标的物。具体协议只可载列在各重大方面与本协议所规定的具约束力的原则、指引、条款及条件相一致的规定;如与本协议存在不一致,应以本协议项下规定为准。

4、协议期限和协议的终止

本协议的有效期从2025年1月1日起至2028年6月30日止。本协议在符合有关法规及上市地上市规则的前提下,经甲乙双方同意可以延长或续期。

5、违约责任

各方均应当按照本协议的约定履行各自的义务,未按照本协议约定条款履行义务而给对方造成损失的应当承担赔偿损失等违约责任。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年,公司与日月光投资及附属公司发生的各类关联交易累计金额为134,808万元。

五、交易目的及对公司影响

公司本次签署《框架协议》主要为满足公司日常生产运营的需要,以公司正常经营业务为基础,交易遵循公平原则,交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准,不会对公司独立性及规范运作产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-024
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 理财产品投资类型:低风险型理财产品

● 理财产品投资额度:总额度不超过人民币50亿元

● 已履行及拟履行的审议程序:本次理财产品投资事项已经环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受到宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、理财产品投资概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有闲置资金进行理财产品投资,增加公司收益。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币50亿元进行理财产品投资（占2024年12月31日公司经审计的净资产18,058,531,465.32元的27.69%）,在额度内可循环使用。

（三）资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司运用自有资金投资的理财产品均流动性好,包括但不限于银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

（五）投资行为授权及期限

本次使用自有闲置资金进行理财产品投资的授权期限自2025年4月1日至2026年3月31日,单个理财产品的投资期限不超过一年。同时授权董事长或董事长授权人员在授权期限及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2025年3月28日召开的第六届董事会审计委员会第八次会议、第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》。鉴于自有闲置资金进行理财产品投资的额度处于董事会决策权限内,该议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案;由公司财务负责人进行审核,按公司核决权限提交审批。

2、公司稽核中心负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,就其合规情况向审计委员会报告。

3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部应建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

5、公司将依据相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司进行理财投资的本金计入资产负债表中交易性金融资产,理财收益计入利润表中投资收益。

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营的前提下,以自有闲置资金适度进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,提升公司整体业绩水平,回报公司股东。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-026
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司
关于控股子公司之间互相提供担保的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司全资子公司Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg Gmbh、Asteelflash Holding GmbH、ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为2,200万欧元;截至目前已实际为其提供的担保金额为2,300万欧元

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:被担保方Asteelflash Germany GmbH、ASTEELFLASH PLZE S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A. 截至2024年12月31日的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述及履行的内部决策程序

（一）担保情况概述

（1）FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Germany GmbH 向Crédit Agricole Corporate and Investment Bank申请授信额度为700万欧元的银行贷款提供担保,担保期限为一年,协议于2025年6月10日到期,计划续签1年。

（2）FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Holding GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh向HSBC Continental Europe S.A.,Germany申请不超过1,000万欧元的银行贷款提供担保,担保期限为一年,协议于2025年9月22日到期,计划续签1年。

（3）FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. 向?eskoslovenská obchodní banka, a.s.申请不超过200万欧元的银行贷款提供担保,担保期限为一年,协议于2025年10月22日到期,计划续签1年。

（4）FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A. 向BRED申请不超过300万欧元的银行贷款提供担保,担保期限为一年,协议于2025年11月14日到期,计划续签1年。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2025年3月28日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了上述控股子公司之间互相提供担保的相关事宜。

鉴于被担保人Asteelflash Germany GmbH、ASTEELFLASH PLZE? S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.截至2024年12月31日的资产负债率超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的有关规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

上述担保均尚未签署担保协议,担保额度为预计金额,实际担保金额以签署的担保合同为准。

二、被担保人基本情况和担保协议主要内容

（一）FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Germany GmbH银行贷款的担保事项

1、被担保人基本情况

序号	被担保人	注册地点	经营范围	公司持股比例
1	Asteelflash Germany GmbH	Konrad-Zuse-Strae 19-21 36251 Bad Hersfeld,Germany	从事电子产品的设计、制造及加工	100%

2、被担保人2024年经审计财务数据

单位:万欧元

项 目	Asteelflash Germany GmbH
资产总额	7,810
负债总额	6,331
其中:银行贷款总额	497
流动负债总额	4,991
净资产	1,479
项 目	
营业收入	10,327
净利润(损失)	(164)

3、担保协议的主要内容

主要担保方式:信用担保
担保期限:自协议签署之日起一年
担保金额:700万欧元

（二）FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Holding GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh向HSBC Continental Europe S.A.,Germany银行贷款的担保事项

1、被担保人基本情况

序号	被担保人	注册地点	经营范围	公司持股比例
1	Asteelflash Holding GmbH	Konrad-Zuse-Strae 19-21 36251 Bad Hersfeld,Germany	从事电子产品的设计、制造及加工	100%
2	Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh	Meiendorfer Stra e 205 22145 Hamburg, Germany	从事电子产品的设计、制造及加工	100%

2、被担保人2024年经审计财务数据

单位:万欧元

项 目	Asteelflash Holding GmbH	Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh
资产总额	1,730	702
负债总额	476	447
其中:银行贷款总额	109	216
流动负债总额	462	399
净资产	1,254	255
项 目		
营业收入	38	605
净利润(损失)	88	(26)

被担保人Asteelflash Germany GmbH的基本情况及2024年经审计财务数据见前表。

3、担保协议的主要内容

主要担保方式:信用担保
担保期限:自协议签署之日起一年
担保金额:1,000万欧元

（三）FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. 向?eskoslovenská obchodní banka, a.s.银行贷款的担保事项

1、被担保人ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.基本情况

序号	被担保人	注册地点	经营范围	公司持股比例
1	ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.	Building BP 8, industrial complex of City park Plzen, cadastral area Skvrnany	从事电子产品的设计、制造及加工	100%

2、被担保人2024年经审计财务数据

单位:万欧元

项 目	ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.
资产总额	1,689
负债总额	1,301
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	493
净资产	388
项 目	
营业收入	2,182
净利润(损失)	(13)

3、担保协议的主要内容

主要担保方式:信用担保
担保期限:自协议签署之日起一年
担保金额:200万欧元

（四）FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A. 向BRED银行贷款的担保事项

1、被担保人ASTEELFLASH TUNISIE S.A.基本情况

序号	被担保人	注册地点	经营范围	公司持股比例
1	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	104 avenue de l'UMA 2045 La Soukra	从事电子产品的设计、制造及加工	100%

2、被担保人2024年经审计财务数据

单位:万欧元

项 目	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.
资产总额	10,443
负债总额	8,432
其中:银行贷款总额	192
流动负债总额	5,114
净资产	2,011
项 目	
营业收入	14,213
净利润(损失)	43

3、担保协议的主要内容

主要担保方式:信用担保
担保期限:自协议签署之日起一年
担保金额:300万欧元

三、担保的必要性和合理性

因经营需要,公司全资子公司FINANCIERE AFG分别为其全资子公司Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh、Asteelflash Holding GmbH、ASTEELFLASH PLZE? S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.的银行贷款提供担保,该行为是为满足被担保公司正常经营的资金需求的合理安排;被担保人是公司合并报表范围内的全资子公司,公司能够及时掌握其偿债能力,违约风险和财务风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

四、董事会意见

公司控股子公司之间互相提供担保事项涉及的被担保方均为公司纳入合并报表范围的全资子公司,公司可以对其经营做出决策并及时掌握其财务和资信状况。该等担保事项有利于被担保方经营运作,提高资金使用效率,符合公司整体利益,未违反相关法律法规及公司制度的规定,公司董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为2,300万欧元（按照2024年12月31日汇率计算为人民币17,309.11万元）,全部为控股子公司之间互相提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的0.96%;公司对控股子公司提供的担保总额为0,占公司最近一期经审计净资产的0%;上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0,占公司最近一期经审计净资产的0%;不存在逾期担保。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-027
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司
关于续聘会计事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计事务所名称:德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生,2024年末合伙人人数为204人,从业人员共5,616人,注册会计师共1,169人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元,其中审计业务收入为人民币32亿元,证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共22家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤华永曾受到行政处罚一次,受到证券监管机构的行政监管措施两次,受到自律监管措施一次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,四名从业人员受到行政监管措施各一次,五名从业人员受到自律监管措施各一次;一名2021年已离职的前员工,因个人行为于2022年受到行政处罚,其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师原守清先生,自1994年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,1996年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。原守清先生近三年签署的上市公司审计报告共5份。原守清先生自2021年开始为公司提供审计专业服务。

签字注册会计师胡科先生,自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2008年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。胡科先生近三年签署的上市公司审计报告共7份。胡科先生自2021年开始为公司提供审计专业服务。

质量复核人步君先生,自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2007年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。步君先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共4份。

2、诚信记录

德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人以及审计项目组成员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2024年度财务报告审计费用为人民币466万元,内部控制审计费用为人民币118.3万元。2023年度财务报告审计费用为人民币440万元,内部控制审计费用为人民币73.6万元。2024年度审计费用相较于上年度同比增加13.77%。2024年度审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

2025年度审计费用将以2024年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定,并履行相关审议程序。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司2025年3月28日召开第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于〈会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》《关于续聘2025年财务审计机构的议案》和《关于续聘2025年内部控制审计机构的议案》,并发表如下审议意见:审计委员会对德勤的专业资质、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意续聘德勤为公司2025年度财务审计及内控审计服务机构,并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》,对德勤华永2024年度履职情况的评价为:"公司认为德勤华永在担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则及执业规范要求,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,对公司的财务报表和内部控制进行了审计,能够独立、客观、公正地发表审计意见,切实履行了审计机构应尽的职责。"

第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2025年财务审计机构的议案》和《关于续聘2025年内部控制审计机构的议案》,一致同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务审计和内部控制审计服务机构。

（下转B043版）